

便簽 日期：106年11月13日  
單位：研究發展處

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

計畫業務組 擬辦：

- 一、文陳閱後，公告於電子公佈欄、本組、本處及本校最新消息，並e-mail副知全校教師知照。
- 二、計畫主持人請於校內申請截止日106年12月26日上午10時前於科技部系統完成線上申請作業，並立即填送「國立中興大學申請科技部研究計畫計畫主持人聲明書」至申請單位(系、所、中心)。
- 三、申請單位須於106年12月27日上午10前至科技部系統列印申請名冊1份經單位主管核章後，併同「國立中興大學申請科技部研究計畫申請單位切結書」送至研發處計畫業務組，逾期恕不受理。
- 四、另提醒申請者於提出計畫申請案前，務必更新或確認個人資料（職稱請以人事室核發之正式職稱為準）。
- 五、文存。

會辦單位：

| 第二層決行                    |      |                                    |
|--------------------------|------|------------------------------------|
| 承辦單位                     | 會辦單位 | 決行                                 |
| 行政組 張譯云 1113<br>1043     |      |                                    |
| 副教授 李思禹 1114<br>兼組長 1428 |      | 代為決行<br>教授兼 洪慧芝 1114<br>研究發展處 1428 |

## 科技部 函

機關地址：台北市和平東路二段106號  
聯絡人：潘敏治 副研究員  
電話：02-2737-7983  
傳真：02-2737-7673  
電子信箱：mcpa@most.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國106年11月10日  
發文字號：科部工字第1061005863號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：修正107年度「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」公告內容，詳如說明，請查照。

說明：

一、本部106年9月7日科部工字第1060070326號函諒達，本次修正重點摘錄如下：

- (一)增列主軸六「新興半導體製程、材料與元件技術」，同時主軸一名稱原為「關鍵元件、製程與材料、感測器」修正為「前瞻感測元件、電路與系統」。
- (二)申請人之任職機構原應於106年11月20日(星期一)前備函送達本部，延至106年12月29日(星期五)前送達。
- (三)本專案為整合型計畫，每一整合型計畫需含總計畫與(三個(含)以上，最多以不超過六個為原則)之子計畫。
- (四)原計畫名稱「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫」修正為「智慧終端半導體製程與晶片系統研發專案計畫(半導體射月計畫)」。
- (五)計畫具體目標導向：總計畫內容須明確陳述整體總目標，應具有開創新思維且以挑戰數量等級的規格改善為宗旨。



(六)申請團隊於提出總計畫書時，必須包含【業界合作意願書】，請將此意願書附於計畫書表CM03 研究計畫內容之後，並於計畫內容簡述申請團隊與業界預計之合作方式。

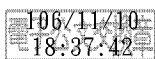
(七)本計畫規劃四年期間修正自107年5月1日至111年4月30日，業經審查通過，核定補助二年期間修正自107年5月1日至109年4月30日。

二、本計畫修正細節，請詳閱公告相關內容紅色字體所示。

三、本計畫徵求公告相關內容業已公佈於本部網站與本部工程司網站(<https://www.most.gov.tw/eng/ch>)-公告事項。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司



部長陳良基

